

Title (en)
Apparatus and method for cutting a web

Title (de)
Vorrichtung und Verfahren zum Schneiden einer Bahn

Title (fr)
Appareil et méthode pour couper une bande

Publication
EP 1106551 A2 20010613 (DE)

Application
EP 00124482 A 20001109

Priority
US 45297599 A 19991202

Abstract (en)
The cutter consists of a number of straight cutter elements (3a,b,c,d.13a,b,c,d.) for cutting the web of material (1) into signatures (7). Gripper elements (4a,b,c,d..14a,b,c,d..) cooperate with the cutter elements The cutter elements are moved along a first and second path (105,106) between which is the signature cutting part (1000).

Abstract (de)
Eine Vorrichtung zum Schneiden einer Materialbahn (1), die mit einer Bahngeschwindigkeit in eine Bahnrichtung bewegt wird, umfasst eine Vielzahl von geradlinig in Bahnrichtung bewegbaren Schneidelementen (3a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) zum Schneiden der Bahn (1) in Signaturen (7) und eine Vielzahl von Greiferelementen (4a, 4b, 4c, 4d etc. 14a, 14b, 14c, 14d etc.), die mit den Schneidelementen (3a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) zusammenwirken. Ein Verfahren zum Schneiden einer Bahn (1), die sich in einem Signaturschneidbereich (1000) in eine Bahnrichtung bewegt, sieht vor, dass eine Vielzahl von Schneidelementen (3 a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) in einem Signaturschneidbereich (1000) geradlinig in Bahnrichtung bewegt werden; dass die Vielzahl von Schneidelementen (3 a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) die Bahn (1) in Signaturen (7) schneidet; dass die Signaturen (7) ergriffen werden; und dass die Länge der Signaturen (7) durch Steuern der Abstände zwischen den Schneidelementen (3 a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) in dem Signaturschneidbereich (1000) verändert wird. <IMAGE>

IPC 1-7
B65H 35/00

IPC 8 full level
B41F 13/56 (2006.01); **B26D 1/20** (2006.01); **B26D 1/56** (2006.01); **B26D 11/00** (2006.01); **B65H 29/02** (2006.01); **B65H 35/04** (2006.01); **B65H 35/06** (2006.01); **B65H 45/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B26D 1/205 (2013.01 - EP US); **B26D 1/565** (2013.01 - EP US); **B26D 11/00** (2013.01 - EP US); **B65H 29/02** (2013.01 - EP US); **B65H 35/04** (2013.01 - EP US); **B65H 2301/51512** (2013.01 - EP US); **B65H 2403/542** (2013.01 - EP US); **B65H 2405/55** (2013.01 - EP US); **Y10T 83/4778** (2015.04 - EP US); **Y10T 83/478** (2015.04 - EP US)

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1106551 A2 20010613; **EP 1106551 A3 20030604**; **EP 1106551 B1 20040929**; AT E277854 T1 20041015; DE 10055582 A1 20010607; DE 50007977 D1 20041104; JP 2001206622 A 20010731; JP 4690538 B2 20110601; US 2003115997 A1 20030626; US 6684746 B2 20040203

DOCDB simple family (application)
EP 00124482 A 20001109; AT 00124482 T 20001109; DE 10055582 A 20001109; DE 50007977 T 20001109; JP 2000368432 A 20001204; US 45297599 A 19991202